

帝科股份“豪赌”半导体第二增长曲线

逾五成募资押向存储业务

作为一家主营光伏银浆的上市公司,近年来,帝科股份持续加码存储芯片赛道。

4月22日,帝科股份发布定增预案显示,拟定增募资不超过30亿元,扣除发行费用后,将用于年产2000吨贱金属少银光伏浆料项目、1450t/a电子级金属粉体扩能升级项目、下一代高效光伏电池金属化浆料研发项目、存储芯片封装测试基地项目、半导体封装研发中心项目、偿还银行贷款和补充流动资金。

值得关注的是,此次募投项目中,“存储芯片封装测试基地项目”和“半导体封装研发中心项目”两项直指半导体领域,帝科股份拟分别投入募资金额约11.4亿元、4.32亿元,合计约15.72亿元。经北京商报记者计算,上述两个项目的拟投入募资金额占募资金总额的52.4%。

2020年,帝科股份登陆A股市场,主要从事用于光伏电池金属化环节的导电浆料产品的研发、生产和销售,2024年开始布局存储业务。据了解,该公司相继完成对因梦控股和江苏晶凯股权的收购,构建起从存储晶圆测试分选服务、芯片封装方案设计、封装服务到成品测试、老化测试的一体化产业链。

财报显示,2025年,帝科股份存储芯片业务收入同比增长高达574.63%,但占当年的营收比例不足3%。具体来看,2025年,帝科股份的存储芯片产品收入约5.03亿元,占营收的2.79%,同比增长574.63%。此外,光伏材料产品收入约148.66亿元,占比为82.38%,同比增长15.56%;材料销售、电子材料产品及其他收入分别约为23.57亿元、3046.38万元、2.89亿元,占比分别约为13.06%、0.17%、1.6%。

需要注意的是,截至2025年末,帝科股份资产负债率达82.34%。此次募集资金将投入

光伏银浆巨头帝科股份欲再度加码半导体。4月22日,帝科股份发布的定增预案显示,公司计划募资不超30亿元,其中过半募资金额将投入存储芯片相关项目,以加强公司第二增长曲线。

当下,半导体行业已成为A股市场的最热赛道之一,吸引包括帝科股份在内的多家上市公司跨界入局。不断押注半导体的背后,2025年帝科股份净利也出现亏损,这场跨界“豪赌”能否让公司真正破局,仍需时间检验。

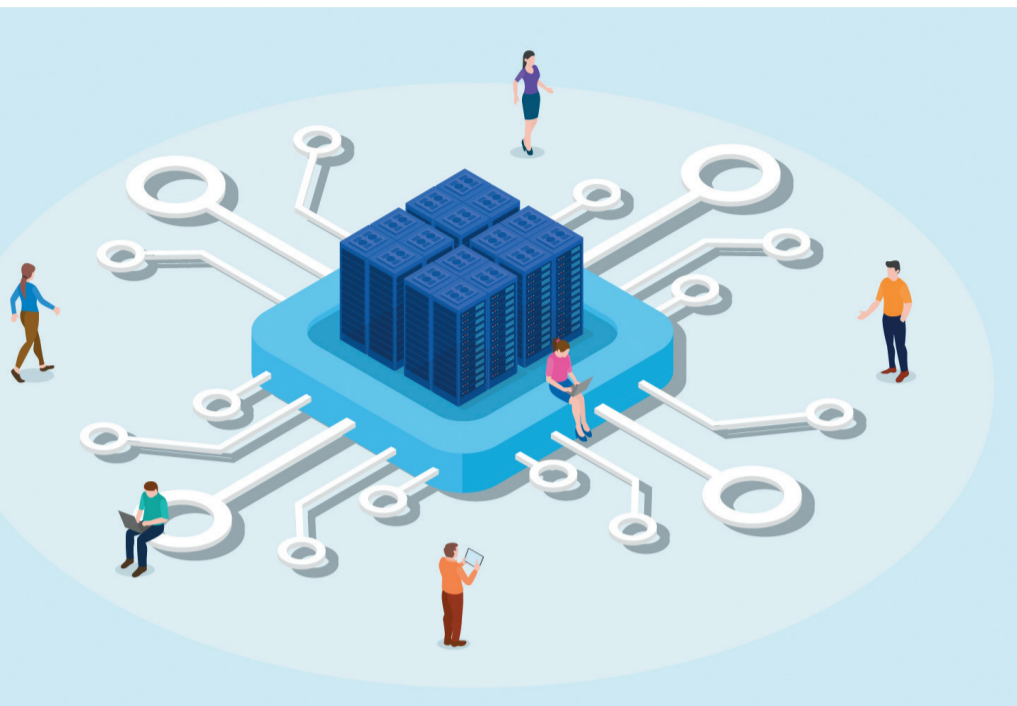
9亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。对此,帝科股份方面提到:“这有利于缓解公司发展过程中的资金压力。”

6.39亿元商誉悬顶

帝科股份的商誉飙升尤为突出。年报显示,该公司账上商誉从2024年末的3323.22万元增至6.39亿元。其中,因收购浙江紫璞新材料有限公司形成的商誉金额为4538.95万元,收购江苏晶凯股权形成的商誉金额约1.44亿元。同时,帝科股份还完成对浙江索特材料科技有限公司股权的收购,此次并购形成商誉金额达4.25亿元。

此外,2025年年报显示,对于帝科股份的控股子公司无锡湃泰电子材料科技有限公司,需计提商誉减值约874.86万元。

新智派新质生产力会客厅联合创始发起



人袁帅告诉北京商报记者,商誉本质是企业并购时支付的溢价,远超标的资产公允价值的部分可能需要在后续年度进行减值测试,若收购的资产未能达到预期盈利水平,大额商誉减值将直接侵蚀当期利润,甚至可能导致公司出现阶段性亏损。

从基本面看,帝科股份2025年营收创上市以来新高,但归属净利润则出现亏损。年报显示,2025年,帝科股份营收约180.46亿元,同比增长17.56%;归属净利润约为-2.76亿元,同比转亏;扣非后归属净利润约为1.63亿元,同比下降62.78%。

对此,帝科股份方面表示,这主要源于非经常性损益,对归属净利润的影响金额约为-4.4亿元。为应对银粉价格波动风险,公司通过白银期货合约进行对冲操作;为降低银粉采购成本和应对银粉价格波动风险,公司进行了白银租赁业务。本期,银点快速、

大幅上涨,公司对白银期货和白银租赁按照资产负债表日银点计提的公允价值变动损失金额较大。

在二级市场上,今年3月3日以来,帝科股份股价震荡走低,经统计,3月3日—4月22日,该公司股价区间累计跌幅达27.8%。截至4月22日收盘,股价收跌0.02%,收于85.3元/股,总市值123.9亿元。

针对相关情况,北京商报记者向帝科股份方面发去采访函进行采访,但截至发稿,未收到公司回复。

多家公司跨界半导体

尽管目前帝科股份的存储业务体量尚小,但帝科股份方面也提到,在存储芯片领域,公司明确存储业务作为第二主业,持续加大投入,目标未来两三年发展成为国内领先

的第三方DRAM存储模组企业。

而从帝科股份持续加码存储芯片的资本动作中,也可以窥见当前资本市场半导体并购的热潮。2025年以来,已有多家上市公司将目光投向半导体领域的跨界并购。2026年以来,该趋势延续,经北京商报记者不完全统计,开年以来,康欣新材、延江股份、明阳智能、盈新发展等多家上市公司发布了拟跨界收购半导体资产的消息。

对于上市公司跨界并购半导体资产的核心考量,影响力研究院品牌与IP委员会主任陈彦硕认为,一是原有主业触及增长天花板,亟须寻找高景气赛道;二是半导体作为“硬科技”标签,有助于提升估值溢价和融资能力;三是部分企业试图通过并购获取技术或客户资源,实现业务协同。

袁帅则提到,上市公司跨界并购半导体资产,是顺应产业升级的大趋势。半导体行业的高成长性,有利于提升公司整体估值和盈利水平,不少传统行业上市公司希望通过切入半导体赛道,实现业务结构的转型升级,摆脱原有行业增长瓶颈的限制。

不过,袁帅进一步表示,此类跨界并购也存在诸多潜在风险,首先是估值泡沫风险,半导体资产受行业热度影响,并购时往往估值较高,容易形成大额商誉。其次是业务整合风险,半导体行业的技术迭代节奏、人才管理模式、客户运营逻辑都和传统行业存在较大差异,若上市公司缺乏相关行业的运营经验,容易出现并购后团队磨合不畅、技术落地不及预期、客户资源无法打通等问题,导致并购的资产无法产生预期收益。此外,半导体行业属于资本密集、技术密集型行业,后续持续研发投入、产能扩建都需要大量资金支持,若公司后续现金流跟不上,很可能出现新旧业务都受拖累的局面,反而削弱公司整体的抗风险能力。

北京商报记者 马换换 李佳雪



实控人身背超7亿元担保 莱普科技IPO胜算几何

在问询阶段排队近半年后,成都莱普科技股份有限公司(以下简称“莱普科技”)科创板IPO迎来新进展,该公司近日对外披露了首轮审核问询函回复。本次冲刺上市背后,2025年,莱普科技营收、归属净利润均同比增长,但扣非后归属净利润出现小幅下滑,并且预计2026年一季度扣非后归属净利润为负值。在审核问询函中,上交所对莱普科技单一客户的重大依赖情况、实控人大额担保情况等给予重点关注。

一季度扣非后净利预降

近日,上交所官网显示,莱普科技科创板IPO对外披露了首轮审核问询函回复。据了解,莱普科技以先进精密激光技术及半导体创新工艺开发为核心,主要从事高端半导体专用设备的研发、生产和销售,并提供相关技术服务。该公司IPO于2025年9月29日获得受理,当年10月26日进入问询阶段。

从基本面看,2022—2024年,莱普科技营收分别约为7414.56万元、1.91亿元、2.81亿元;归属净利润分别为-879.62万元、2303.67万元、5564.28万元;扣非后归属净利润分别为-920万元、2177.26万元、4834.56万元。

2025年,莱普科技营收、归属净利润再度同比增长。其中,营收约3.5亿元,同比增长24.71%;归属净利润约7230.39万元,同比增长29.94%,但扣非后归属净利润同比下降15.49%。对此,莱普科技方面表示,2025年,由于“全国总部暨集成电路装备研发制造基地项目”厂房转固,折旧摊销费大幅上升等原因,公司2025年度实现扣非后归属净利润较2024年度下降。

另外,莱普科技预计,2026年一季度营收为5000万—5500万元,同比增长36.51%—50.16%;归属净利润为220万—650万元,同比增

长175.15%—712.96%;扣非后归属净利润约为-500万元—70万元,同比下降837.7%—31.28%。

“通常,如果因厂房、设备等长期资产转固带来的非经常性损益之外的成本增加,扣非后归属净利润的下滑便属于阶段性现象,随着产能利用率的提升,折旧摊销对利润的影响会逐步被消化。”中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅表示,但需要警惕的是,若成本上升的背后还隐藏着主营业务毛利率下滑、费用管控失当等其他问题,那么这种下滑便不是阶段性的,而是企业经营基本面出现问题的信号。

本次冲刺上市,莱普科技拟募集资金约8.5亿元,扣除发行相关费用后的净额,拟按照轻重缓急投资晶圆制造设备开发与制造中心项目,先进封装设备开发与制造中心项目,研发中心及信息化建设项目,研发、技术支持与营销网络建设项目,补充流动资金。

对客户A销售占比近六成

本次冲刺上市背后,莱普科技单一客户重大依赖的情况颇为显眼。

招股书显示,2022—2024年以及2025年前三季度,莱普科技向前五大客户的销售金额,占当期营业收入的比例分别为66.86%、65.89%、83.45%和81.5%。其中,向客户A及其

同一控制下的其他主体的销售金额,占当期营业收入的比例分别为18.86%、42.87%、67.86%和59.3%;向客户A及其同一控制下其他主体的销售毛利,占当期毛利的比例分别为28.42%、63.62%、81.52%和73.49%。

对此,上交所问询函中给予重点关注,要求莱普科技说明单一客户重大依赖的原因及合理性。对此,该公司回复称,报告期内对单一客户的重大依赖情形与下游行业发展格局及自身行业经营特点相符,不存在下游行业较为分散而公司自身客户较为集中的情形。

在控制权方面,控股股东东骏投资直接持有莱普科技26.77%的股份;实控人叶向明、毛冬分别持有东骏投资50%股权,合计控制66.94%公司有表决权股份。

值得注意的是,莱普科技实控人存在大额对外担保的风险,截至2026年2月25日,叶向明、毛冬对东骏电器、汉邦能源等其控制企业以外的第三方提供的担保债务本金余额为7.36亿元,其中东骏电器担保债务本金余额5.52亿元、汉邦能源担保债务本金余额1.84亿元。

针对相关情况,北京商报记者向莱普科技方面发去采访函进行采访,但截至发稿,未收到公司回复。

北京商报记者 王蔓蕾

S 侃股 Stock talking

股息率稳定更关键

周科竞

在已披露年报的上市公司中,目前有约20家上市公司的股息率高于5%。但是股息率并非越高越好,稳定更为关键。如果只是单一某一次的股息率特别高,对公司长期价值的提升并无太大意义,反而可能成为投机炒作的噱头。

单次超高股息率并不能代表上市公司持续的分红能力。部分上市公司会在单一年度推出高额分红方案,推高当期股息率。这类行为大多具有偶然性,有可能来自阶段性利润结余、闲置资金利用等一次性因素,并不代表公司已经建立常态化的分红机制。这类单次的高股息表现,难以改变上市公司整体的经营结构与盈利质量,无法持续回馈长期持股的投资者,对于公司长期价值提升没有太大益处。

不仅如此,单次高股息率很容易沦为市场短期炒作的噱头。部分资金利用投资者偏好高分红心理,借助单次高额分红消息炒作股价,完成短期套利。炒作结束后,股价大概率回归原有运行区间。对于跟风买入的投资者,单纯追逐单次高股息股票,本质属于短线投机行为,无法实现长期稳定收益,也违背了价值投资的初衷。

稳定的股息率,对应的是稳定的经营能力与成熟的公司治理。能够长期保持稳定分红的上市公司,普遍具备稳定的盈利能力、可控的经营风险以及充裕的经营性现金流。这类上市公司大多业务模式成熟,具备持续回馈股东的

基础条件。常态化的分红,是公司经营稳健最直观的信号,也是上市公司重视股东回报、治理规范的直接体现。

从投资角度看,稳定的股息率可以为投资者提供持续性的股息收益。A股市场波动频繁,股价涨跌存在较强不确定性。稳定的现金分红,可以让投资者不必完全依赖股价上涨获利,通过长期持股持续获取分红收益,可以有效抑制账户波动,降低单一依靠价差收益的投资风险。长期来看,具备稳定分红能力的上市公司,估值更加扎实,股价波动更小,市场认可度更高,更容易走出长期稳健的慢牛行情。

对于上市公司来说,维持稳定的股息率,也是完善自身经营、提升治理体系的重要方式。常态化分红要求上市公司持续保证盈利质量,审慎规划资金用途,平衡业务发展与股东回报。长期坚持稳定分红的经营策略,能够持续向市场传递正面信号,吸引长期机构资金入驻,改善公司股东结构,进一步推动公司估值回归合理水平,形成经营、分红、估值互相促进的良性循环。

对于普通投资者而言,需要纠正唯高股息率论的认识误区。筛选高股息上市公司时,不应只关注单一年度的分红数据,更要拉长周期,观察上市公司连续数年的分红比例、分红持续性与现金流水平,区分一次性分红与常态化分红,摒弃短线炒作思维,更多关注具备持续分红能力的上市公司。